

证券代码：870013

证券简称：天科合达

主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司 关于注销 2017 年股票发行募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、2017 年股票发行募集资金基本情况

北京天科合达半导体股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》等议案，并于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2017 年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-025）。2017 年 8 月 17 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过该次股票发行相关议案，并于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2017-029）。2017 年 9 月 19 日，公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2017 年第一次股票发行方案（更正后）》（公告编号：2017-040）。根据《2017 年第一次股票发行方案（更正后）》，公司 2017 年股票发行数量为 16,666,666 股，发行价格为每股人民币 2.70 元，募集资金合计人民币 45,000,000.00 元。公司于 2017 年 8 月 24 日前收到认购人缴纳的股份认购款 45,000,000.00 元；2017 年 9 月 6 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]第 ZB11947 号”

《验资报告》，验证公司收到全部股份认购款。

2017年9月21日，全国股转系统出具《关于北京天科合达半导体股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5714号），确认公司本次股票发行16,666,666股，其中限售382,500股，不予限售16,284,166股。

二、2017年股票发行募集资金实际使用情况

截至2019年8月7日，公司2017年股票发行募集资金的实际使用情况如下：

项目	实际金额
募集资金总额	45,000,000.00
加：利息收入	56,681.93
减：采购产品生产设备	15,000,000.00
减：研发投入	10,032,666.43
减：补充流动资金	20,024,015.50
募集资金余额	0.00

截至2019年8月7日，公司2017年股票发行募集资金存在使用用途变更的情况。根据《2017年第一次股票发行方案（更正后）》，公司2017年股票发行募集资金原计划采购的生产设备清单中部分设备采购尾款562.00万元尚未到付款期，为提升募集资金使用效率，将该部分募集资金用途变更为支付新增采购生产设备的预付款。2018年5月11日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意对562.00万元原用于采购生产设备的募集资金所采购生产设备明细进行变更：

募集资金用途	变更前募集资金（万元）	变更后募集资金（万元）
采购产品生产设备	1500.00	938.00
新增采购产品生产设备	-	562.00

三、2017 年股票发行募集资金专项账户注销情况

（一）募集资金专项账户基本信息

户名：北京天科合达半导体股份有限公司；

开户行：华夏银行股份有限公司北京阜外支行；

账号：10260000000783247。

（二）募集资金专项账户注销情况

2019 年 8 月 9 日，公司对上述募集资金专项账户进行了注销，账户注销后相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日